

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6584125

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
TAKUMA OKUBO	02/25/2021
KENJI OHATA	02/25/2021
AKIHITO YAMADA	03/01/2021
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	LINTEC CORPORATION
<b>Street Address:</b>	23-23, HONCHO, ITABASHI-KU
<b>City:</b>	TOKYO
<b>State/Country:</b>	JAPAN
<b>Postal Code:</b>	1730001
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
Application Number:	17273437
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(703)991-7071
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
<b>Phone:</b>	7037408322
<b>Email:</b>	patent@maierandmaier.com
<b>Correspondent Name:</b>	MAIER & MAIER, PLLC
<b>Address Line 1:</b>	345 SOUTH PATRICK STREET
<b>Address Line 4:</b>	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	11320023US
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	CHRISTOPHER J. MAIER
<b>SIGNATURE:</b>	/Christopher J. Maier/
<b>DATE SIGNED:</b>	03/04/2021
<b>Total Attachments: 3</b>	
source=Assignment#page1.tif	
source=Assignment#page2.tif	
source=Assignment#page3.tif	

# ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

## 特許出願宣言書付き譲渡書 (37 CFR 1.63)

### Japanese Language Assignment with Declaration

下記に署名した発明者であり、以下に譲渡人と称される私（我々）は、下記の出願に記載された改良に関する発明をし、

\_\_\_\_\_ の \_\_\_\_\_ (譲受人) は、本件出願および本件発明、ならびに当該出願から得られるいかなる米国特許に関する全ての権利、権原、および利益の取得を要求します。

よって、価値ある対価の受領をここに確認し、

上で譲渡人として指名された私（我々）は、米国における本件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出願、これら出願について許可された米国特許証および全ての再発行特許に関する全ての権利（35 USC 119に基づく優先権を主張する権利と過去分の損害賠償請求権を含む）、権原、および利益を、上で指定した譲受人、その承継人ないし権利承継者に売却、譲渡、移転するとともに、私（我々）は米国特許商標庁長官に対し、本件出願に記載の発明に対する特許証を、譲受人、その承継人ないし権利承継者に発行することを要請し、私（我々）は、これ以上の対価なしに、譲受人の求めにより、本件米国特許出願に関して譲受人が必要とみなす全ての書類を作成します。

(公証人による認証は不要であるが、これらの書類は、35 USC 261に基づく推定された証拠となる)

私は、下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。

本宣言付き譲渡書は、以下に關します。

添付の出願書、または、

2019年9月4日に提出された米国出願あるいは PCT 国際出願番号 PCT/JP2019/034839 (確認番号 \_\_\_\_\_)

本件出願の名称は、以下の通りです。

剥離ライナー、剥離ライナーの作製方法、粘着シート、および粘着シートの作製方法

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, LINTEC Corporation of 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

The attached application, or

United States Application or PCT International Application Number PCT/JP2019/034839 filed on September 4, 2019 (Confirmation No. 7073).

The application is entitled:

RELEASE LINER, METHOD FOR PRODUCING RELEASE LINER, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE SHEET, AND METHOD FOR PRODUCING PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE SHEET

### Japanese Language Assignment with Declaration

上記に明示された出願は、私が作成した、または作成を許可したものです。

私は、本件出願において請求項に記載された発明の本来の発明者、または、本来の共同発明者であると信じています。

私は、本宣言付き譲渡書の提出に関わる本件出願の内容を検討し、理解しています。

私は、37 CFR 1.56に定義されるように、自身を知る全ての特許性に関する重要な情報を、米国特許商標庁に開示する義務があることを認識しています。

私は、本宣言付き譲渡書において故意に虚偽の供述を行った場合、18 USC 1001に基づき、罰金あるいは5年以下の懲役、または両方による処罰の対象となることを認識しています。

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

#### STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature



Date

March 11, 2014

<b>NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:</b> 唯一あるいは第一の発明者名		
Given Name (first and middle [if any]) 名 (名およびミドルネーム[該当する場合])	Takuma	Family Name or Surname 姓 OKUBO
Inventor's signature 発明者の署名	Takuma Okubo	Date 日付 February 25, 2021
Residence: 住所: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		
<b>NAME OF SECOND INVENTOR:</b> 第二の発明者名		
Given Name (first and middle [if any]) 名 (名およびミドルネーム[該当する場合])	Kenji	Family Name or Surname 姓 OHATA
Inventor's signature 発明者の署名	Kenji Ohata	Date 日付 February 25, 2021
Residence: 住所: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		
<b>NAME OF THIRD INVENTOR:</b> 第三の発明者名		
Given Name (first and middle [if any]) 名 (名およびミドルネーム[該当する場合])	Akihito	Family Name or Surname 姓 YAMADA
Inventor's signature 発明者の署名	Akihito Yamada	Date 日付 March 1, 2021
Residence: 住所: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan		